

■ 連結貸借対照表

科目	期別	
	当期 平成26年3月31日現在	前期 平成25年3月31日現在
資産の部		
流動資産	13,255	14,867
固定資産	10,228	5,959
有形固定資産	5,704	4,350
無形固定資産	3,005	56
投資その他の資産	1,518	1,552
資産合計	23,483	20,826
負債の部		
流動負債	2,068	594
固定負債	1,061	655
負債合計	3,130	1,249
純資産の部		
株主資本	19,678	19,731
その他の包括利益累計額	663	△169
新株予約権	11	14
純資産合計	20,353	19,576
負債純資産合計	23,483	20,826

■ 連結損益計算書

科目	期別	
	当期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日	前期 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日
売上高	10,381	4,986
売上総利益	2,821	1,655
販売費及び一般管理費	2,594	1,845
営業利益又は営業損失(△)	226	△190
経常利益又は経常損失(△)	263	△30
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△)	267	△36
当期純損失(△)	△27	△126

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

科目	期別	
	当期 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日	前期 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	827	285
投資活動によるキャッシュ・フロー	△557	366
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58	△0
現金及び現金同等物の期末残高	2,601	2,199

決算のポイント / 株主還元

業績について

当期は光製品関連が好調に売上を伸ばしたほか、期中に不二電子工業株式会社を子会社化した結果、売上高は10,381百万円と前期から倍増し、営業利益と経常利益も赤字を脱却する等、損益を大幅に改善させることができました。

次期の見通し

光通信用部品の需要が引き続き拡大するほか、不二電子工業株式会社の業績が通年で寄与することから平成27年3月期の連結売上高は11,600百万円となり、当期から11%伸長する見通しです。損益面では営業利益640百万円、経常利益650百万円、当期純利益260百万円を見込んでおります。

配当について

当期につきましては、当期純利益を計上することはできませんでしたが、当社の利益還元に対する方針に基づき、1株当たり5円の期末配当を行うことといたします。平成27年3月期の期末配当についても、1株当たり5円を予定しております。

1株当たり 配当金(円)	平成26年3月期	平成27年3月期(予想)
	5円	5円

■ 株式の状況

発行済株式総数	9,333,654株
株主数	3,432名

■ 株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
 定時株主総会 毎年6月
 基準日 毎年3月31日
 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 三井住友信託銀行株式会社
 〒168-0063
 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
 ☎0120-782-031
 (電話照会先)

株式会社精工技研 広報課

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台296番地の1

TEL 047-388-6401(直通) FAX 047-388-4477

E-mail ir@seikoh-giken.co.jp WEB http://www.seikoh-giken.co.jp

株主通信

第42期 事業報告

平成25年4月1日～平成26年3月31日

ごあいさつ

平素より当社に対しまして格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。

当社グループでは、平成22年4月からスタートさせた長期経営計画「マスタープラン2010」の遂行に引き続き取り組んでおります。平成26年3月期は、事業拡大の施策として不二電子工業株式会社を傘下に加えたほか、受注拡大と原価低減に向けた諸施策の実施が奏功し、計画に定めた売上計画100億円を達成することができました。平成27年3月期も事業拡大施策を展開してまいります。株主の皆様におかれましては今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

上野 昌利



業績ハイライト

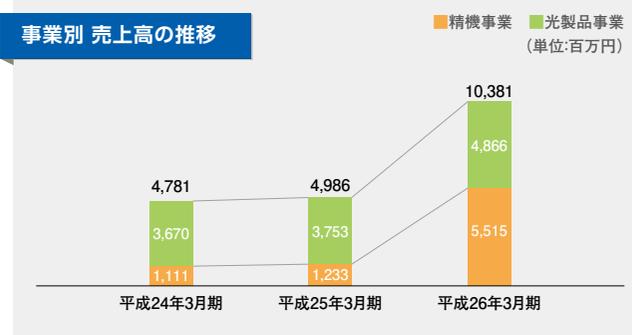


当期、当社グループは、平成22年4月からスタートさせた長期経営計画『マスタープラン2010』の遂行に引き続き取り組みました。『マスタープラン2010』は、筋肉質な企業体質づくりを目指す「事業の再構築」、販売力と商品開発力の強化による「事業拡大」、迅速的確な意思決定を実現する「組織変革」の3つの軸からなる経営計画です。計画4年目となる当期は、「事業拡大」を具現化するための施策として「不二電子工業株式会社」の株式の100%を取得し、連結子会社に加えました。同社はインサート成形やプレス成形の高い技術を用いて、車載用のセンサー関連部品やモバイル端末等に搭載する精密成形品を製造しております。同社が加わったことで当社グループは、製品ラインアップの幅を広げると共に、新たに自動車関連業界に安定した顧客基盤を確立することができました。今後は、当社グループが持つ金型技術と同社の成形技術との接点から新たなシナジーを創出し、当社グループの一層の飛躍につなげてまいりたいと考えております。

また、販売力と価格競争力の強化に向けては、引き続き「受注拡大」と「原価低減」に向けた施策を推進しました。精機関連では、金型技術や精密研磨、精密加工技術の応用により、バイオ・医療等の成長市場を中心に精密成形品を供給する事業の開拓に取り組みしました。光製品関連では、国内をはじめ欧州や中国の展示会に積極的に出展し、顧客基盤の拡大に努めました。中国の製造子会社においては、原価低減を実現するための課題の明確化と課題解決のための施策の具体化を行い、その進捗状況を定期的に本社と共有しながら製造現場の競争力強化を図りました。

その結果、当期の売上高は10,381百万円となり前期から倍増し、『マスタープラン2010』に定めた売上計画100億円を達成することができました。売上高の増加を受けて営業利益は226百万円、経常利益は263百万円となり、前期の赤字から脱却することができました。一方、当期純損益は、27百万円の当期純損失となりました。

事業別の概況



精機事業 超精密金型 / 精密加工 / レンズ

業界最高水準の金型技術と精密加工技術で、お客様の製品開発と生産性向上を支援します。



微細な溝を施した成形品



スマートフォン用レンズ

高い精度が要求される成形品を量産するための金型を製造販売するビジネスに加え、精密な成形品を量産する成形品ビジネスの構築に取り組んでおります。また、平成25年5月に不二電子工業株式会社を傘下に加えたことで、製品ラインアップの拡充と、自動車関連業界に新たに顧客基盤を確立することができました。また、成形品ビジネスの一環である高耐熱レンズ関連では、中国の生産子会社にスマートフォン等のカメラ向け高画素レンズの量産体制を確立する等、事業拡大に向けた布石を打つことができました。これらの結果、当期の精機関連の売上高は5,515百万円となりました。

光製品事業 接続部品 / 光部品 / 製造機器

光通信ネットワークの高速・大容量化を支える高精度な技術・製品を提供します。



MPOコネクタ



MT研磨機

スマートフォンやタブレット端末等の爆発的な普及を背景に、世界的な規模でLTE基地局の敷設が加速しております。こうした需要増加を受けて、光接続用部品や光部品製造用機器を中心に販売が好調に推移しました。一方で、汎用的な部品単価の下落が続いていることから一部の製品の製造を杭州精工技研有限公司へと移管すると共に、部材の現地調達化や工程改善を行う等、原価低減をととして現場の競争力強化を図りました。これらの結果、当期の光製品関連の売上高は4,866百万円となりました。

グループ内連携の活性化 Policy

当社グループはこの数年、長期経営計画「マスタープラン2010」に基づき、他社とのアライアンスを積極的に展開してまいりました。平成24年にはDATA-PIXEL SAS（フランス）、平成25年には精能光學股份有限公司（台湾）と不二電子工業株式会社をグループに加え、規模の拡大に成功しました。平成26年度は新たに「グループ内連携の活性化」を方針に掲げ、グループ内会社間の連携強化による新たな製品、技術、サービス等の付加価値創造に注力していく計画です。

1 不二電子工業(株) とのシナジー

当社が金型を提供することにより、不二電子工業株式会社の成形品の生産効率化を図る活動を展開しております。今後は当社が有する金型技術と不二電子工業株式会社が有する成形技術の融合により、お客様に新たな製品やサービスを提供できるよう努めてまいります。



「技術」「技能」「情報」「人材」の交流を図る

2 DATA-PIXEL とのシナジー

当社は、DATA-PIXELの系列会社RX Solutionsが開発した産業用X線透視CT装置の販売及び非破壊検査受託サービスを開始しました。物体の内部構造を正確に透視し、3次元グラフィックス化ができるこの装置を、公的な研究機関や民間の研究所等に向けて拡販してまいります。



CT装置デモ機



電球の内部構造画像